证券代码：603991　　证券简称：领先股份　　公告编号：2026-069

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司
关于为子公司提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- **担保对象及基本情况**

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
先进半导体材料（深圳）有限公司	90,200 万元	0 万元	是	否

- **累计担保情况**

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	90,200
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	25.79%
特别风险提示（如有请勾选）	□担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产 100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产 30% □本次对资产负债率超过 70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	

一、担保情况概述

（一） 担保的基本情况

为满足深圳市领先半导体科技产业股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内子公司先进半导体材料（深圳）有限公司（以下简称“AMC”）的经营和业务发展需求，公司及子公司先进封装材料国际有限公司（以下简称“AAMI”）、先进半导体材料（安徽）有限公司（以下简称“AMA”）于近日与中国银行股份有限公司深圳南头支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为 AMC 向中国银行申请的最高本金余额人民币 41,000 万元授信额度提供连带责任保证担保，此外，AMA 与中国银行签署《最高额抵押合同》，以位于安徽省滁州市南谯区文忠路 288 号的不动产提供抵押担保，担保的最高债权额为人民币 90,200 万元，本次担保无反担保。

（二） 内部决策程序

公司于 2026 年 9 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，于 2026 年 10 月 12 日召开 2026 年第五次临时股东会审议通过《关于为子公司提供担保预计的议案》，同意公司及子公司为合并报表范围内子公司提供担保，其中为资产负债率 70%以上（含）的子公司担保总额为不超过人民币 4 亿元，为资产负债率 70%以下的子公司担保总额为不超过人民币 10 亿元，本次担保为股东会授权额度内的担保。

（三） 担保额度调剂情况

根据各子公司的实际经营需求，公司在股东会审议批准的担保额度范围内，对合并报表范围内控股子公司的担保额度进行如下调剂：

单位：人民币万元

担保方	被担保方	本次调剂前担保额度	本次调剂金额	本次调剂后担保额度	调剂后尚未使用担保额度（含本次）
公司及子公司	AMC	80,000	+20,000	100,000	9,800
公司及子公司	AMA	20,000	-20,000	0	0

公司及子公司本次为 AMC 提供担保事项在股东会授权范围内，无需另行召开董事会及股东会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	法人		
被担保人名称	先进半导体材料（深圳）有限公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	控股子公司		
主要股东及持股比例	AAMI 持股 100%		
法定代表人	雷国辉		
统一社会信用代码	914403007362812201		
成立时间	2002-06-05		
注册地	深圳市宝安区福海街道和平社区富桥二区厂房 15 栋		
注册资本	4783.5 万美元		
公司类型	有限责任公司（港澳台法人独资）		
经营范围	一般经营项目：从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）；房屋租赁；企业管理服务。（以上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经营）许可经营项目：设计、开发、生产经营半导体专用材料、电子专用工模具；电子专用设备及零部件生产。		
主要财务指标（万元）	项目	2026 年 9 月 30 日/2026 年 1-9 月（未经审计）	2025 年 12 月 31 日/2025 年度（经审计）
	资产总额	149,383	143,322
	负债总额	42,484	34,934
	资产净额	106,899	108,388
	营业收入	154,995	177,044
	净利润	3,981	4,656

三、担保协议的主要内容

（一） 最高额保证合同

保证人：深圳市领先半导体科技产业股份有限公司、先进封装材料国际有限公司、先进半导体材料（安徽）有限公司

债权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行

保证金额：人民币41,000万元

保证方式：连带责任保证

保证范围：合同所担保债权之最高本金余额及在合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

保证期间：合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。

（二）最高额抵押合同

抵押人：先进半导体材料（安徽）有限公司

抵押权人：中国银行股份有限公司深圳南头支行

抵押物：位于安徽省滁州市南谯区文忠路288号的不动产

担保范围：1、本合同所担保债权之最高本金余额为：人民币41,000万元。

2、合同所担保债权之最高本金余额及在合同确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。本合同所担保的最高债权额为人民币90,200万元。

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要。该担保有利于子公司的持续发展，符合公司整体利益和发展战略。本次担保对象为公司控股子公司，公司能对其经营进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，担保风险可控。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

公司于2026年9月24日召开第五届董事会第六次会议，审议了《关于为子公司提供担保预计的议案》，董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了该议案。董事会认为，为子公司提供担保是为了满足其生产经营的需要，符合公司及全体股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 90,200 万元，全部为公司对控股子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的 25.79%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况，无逾期对外担保。

特此公告。

深圳市领先半导体科技产业股份有限公司董事会

2026 年 11 月 6 日